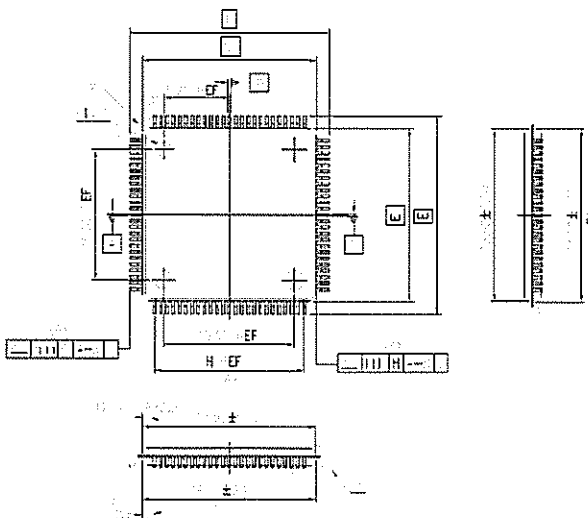


HC32F4A0 LQFP100 产能扩充的通知

客户名称	ALL	联系人	NA
------	-----	-----	----

	商业名称	物料编码
受影响产品	HC32F4A0PITB-LQFP100	2F4A0PI0-0204D0AQ
	HC32F4A0PGTB-LQFP100	2F4A0PG0-0204D0AQ
	HC32F4A0PGTB-LQFP100	2F4A0PG0-0204D0AQ0T
	HC32F4A0PITB-LQFP100	2F4A0PI0-0204D0AQ0T

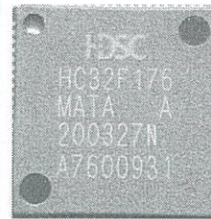
变更原因描述	<p>由于星科金朋产能紧张，为了确保业务连续性，以防出现延期交付、断供等风险。现针对此型号申请扩产封装和测试第二供应商。</p>
--------	--

变更方法描述	<p>1. 供应商扩充</p> <p> 目前封装供应商：星科金朋。扩产后供应商：星科金朋和通富微电；</p> <p> 目前测试供应商：星科金朋。扩产后供应商：星科金朋和广东利扬；</p> <p> 两家封装供应商均为国内排名前三的供应商，测试供应商广东利扬已是华大的合格供应商，扩充的两家供应商，华大均有相同封装类型的其他产品导入量产；</p> <p>2. 扩充至第二家封装供应商后，封装芯片外形尺寸无明显变化；</p> <p> POD 尺寸图示：</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>3. 扩充至第二家封装供应商后，芯片表面印章第三行最后一位字母有变化，N 为通富微电，C 为星科金朋，如下图；</p> <p>4. 扩产至第二家封装供应商通富微电，芯片表面的 Pin 孔有变化，不影响芯片的使用，如下图：</p> <table border="1" style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">原供应商</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">第二封装供应商（通富微电）</td> </tr> </table>	原供应商	第二封装供应商（通富微电）
原供应商	第二封装供应商（通富微电）		

表面 4 个孔 (左上为 Pin1)
印章第三行最后一位字母为 C



表面 3 个孔 (左上为 Pin1)
印章第三行最后一位字母为 N



5. 扩产至第二家测试供应商广东利扬后, 广东利扬的测试机台、测试程序, 都和星科金朋保持一致
6. 扩产后, 包装及标识没有变化
7. 变更验证计划

	待验证厂家	计划验证完成时间	样品准备完成时间
封装	通富微电	2021-12-20	2021-12 月末
测试	广东利扬	2021-10-31	2021-12 月末

8. 变更前在途、在库产品
变更验证通过前涉及物料保持原供应商继续生产, 销售接单不受影响

变更生效日期或产品 Date Code 说明: 扩产通富微电和利扬的变更计划于 2021 年 9 月 10 日生效

发行人 康超

发行日期 2021/9/10

工程运营副总经理签署:

孙子军

日期: 2021.9.14



客户 部确认意见:

签署:

日期:

✎ 以上, 特此通知, 如果您有任何意见或建议, 请随时与我司销售部门联系。✎